# (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-221547 (P2003-221547A)

(43)公開日 平成15年8月8日(2003.8.8)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	FΙ	テーマコード( <del>参考</del> )			
C 0 9 D 163/00	C 0 9 D 163/00		4 J 0 3 8			
5/44		5/44	A			
161/18		161/18				
163/02		163/02				
		審查請求 有	請求項の数25 OL (全 12 頁)			
(21)出願番号	特顧2002-312603(P2002-312603)	(71)出顧人 00000	····································			
(22)出顧日	平成14年10月28日(2002.10.28)	兵庫	<b></b>			
			滋朗			
	特顧2001-357474 (P2001-357474)		川県平塚市東八幡4丁目17番1号 関			
(32) 優先日	平成13年11月22日(2001.11.22)		イント 株式会社内			
(33)優先権主張国	日本(JP)		孝司			
		神奈川	川県平塚市東八幡4丁目17番1号 関			
		西ペー	イント 株式会社内			
		(74)代理人 10006	60782			
		弁理:	士小田島平吉(外2名)			
			最終頁に続く			

# (54) 【発明の名称】 カチオン性塗料組成物

#### (57)【要約】

【課題】 防錆用鋼板の電着塗装性、付着性、防食性及 び低温硬化性に優れた塗膜を形成しうるカチオン性塗料 組成物を提供すること。

【解決手段】 エポキシ当量が180~2500のエポキシ樹脂(A)にキシレンホルムアルデヒド樹脂(B)及びアミノ基含有化合物(C)を反応させてなるキシレンホルムアルデヒド樹脂変性アミノ基含有エポキシ樹脂をビヒクル成分として含有することを特徴とするカチオン性塗料組成物。

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 エポキシ当量が180~2500のエポキシ樹脂(A)に、キシレンホルムアルデヒド樹脂(B)及びアミノ基含有化合物(C)を反応させてなるキシレンホルムアルデヒド樹脂変性アミノ基含有エポキシ樹脂をビヒクル成分として含有することを特徴とするカチオン性塗料組成物。

【請求項2】 エボキシ樹脂(A)が、ポリフェノール 化合物とエピハロヒドリンとの反応により得られるもの である請求項1記載のカチオン性塗料組成物。

【請求項3】 ポリフェノール化合物がビスフェノール Aである請求項2記載のカチオン性塗料組成物。

【請求項4】 エポキシ樹脂(A)が200~2,00 0の範囲内のエポキシ当量を有するものである請求項1 ~3のいずれかに記載のカチオン性塗料組成物。

【請求項5】 キシレンホルムアルデヒド樹脂(B)がフェノール性水酸基を有する請求項1~4のいずれかに記載のカチオン性塗料組成物。

【請求項6】 キシレンホルムアルデヒド樹脂(B)が キシレン、ホルムアルデヒド及びフェノール類を酸性触 20 媒の存在下で縮合反応させて得られるものである請求項 1~5のいずれかに記載のカチオン性塗料組成物。

【請求項7】 キシレンホルムアルデヒド樹脂(B)が キシレンホルムアルデヒド樹脂とフェノール類を酸性触 媒の存在下で反応させて得られるものである請求項1~ 5のいずれかに記載のカチオン性塗料組成物。

【請求項8】 キシレンホルムアルデヒド樹脂(B)が 100~50,000の範囲内のフェノール性水酸基当量を有するものである請求項1~7のいずれかに記載のカチオン性塗料組成物。

【請求項9】 フェノール類がフェノール及びクレゾール類よりなる群から選ばれる請求項6又は7のいずれかに記載のカチオン性塗料組成物。

【請求項10】 キシレンホルムアルデヒド樹脂(B) が20~50,000センチポイズ(25℃)の範囲内の粘度を有するものである請求項1~9のいずれかに記載のカチオン性塗料組成物。

【請求項11】 キシレンホルムアルデヒド樹脂変性アミノ基含有エポキシ樹脂が、エポキシ樹脂(A)に、キシレンホルムアルデヒド樹脂(B)及びアミノ基含有化合物(C)を同時に反応させることにより得られたものである請求項1~10のいずれかに記載のカチオン性塗料組成物。

【請求項12】 キシレンホルムアルデヒド樹脂変性アミノ基含有エポキシ樹脂が、エポキシ樹脂(A)、キシレンホルムアルデヒド樹脂(B)及びアミノ基含有化合物(C)の合計固形分重量を基準にして、エポキシ樹脂(A)を50~90重量%、キシレンホルムアルデヒド樹脂(B)を5~45重量%及びアミノ基含有化合物

(C)を5~25重量%の割合で反応させてなるもので 50 0のカルボキシル基含有ジオール(2)を含有する活性

ある請求項1~11のいずれかに記載のカチオン性塗料 組成物。

【請求項13】 エボキシ樹脂(A)、キシレンホルムアルデヒド樹脂(B)、アミノ基含有化合物(C)、及びさらに複数の活性水素基を含有する化合物にカプロラクトンを付加して得られるポリオール化合物(D)を反応させてなるキシレンホルムアルデヒド樹脂変性アミノ基含有エボキシ樹脂をビヒクル成分として含有する請求項1~12のいずれかに記載のカチオン性塗料組成物。

10 【請求項14】 複数の活性水素基を含有する化合物に おける活性水素基がアルコール性水酸基、第1級アミノ 基及び第2級アミノ基よりなる群から選ばれる請求項1 3に記載のカチオン性塗料組成物。

【請求項15】 複数の活性水素基を含有する化合物が、低分子量ポリオール、線状又は分枝状のポリエーテルポリオール、線状又は分枝状のポリエステルポリオール、第1級及び/又は第2級アミノ基と水酸基とを併有するヒドロキシアミノ化合物よりなる群から選ばれる請求項13又は14に記載のカチオン性塗料組成物。

20 【請求項16】 カプロラクトンがε-カプロラクトン である請求項13~15のいずれかに記載のカチオン性 途料組成物。

【請求項17】 複数の活性水素基を含有する化合物に対するカプロラクトンの付加モル量が、該活性水素基1 当量あたり1~30モルの範囲内にある請求項13~1 6のいずれかに記載のカチオン性塗料組成物。

【請求項18】 キシレンホルムアルデヒド樹脂変性アミノ基含有エポキシ樹脂が、エポキシ(A)に、キシレンホルムアルデヒド樹脂(B)、アミノ基含有化合物(C)、及びポリオール化合物(D)を同時に反応させることにより得られたものである請求項13~17のいずれかに記載のカチオン性塗料組成物。

【請求項19】 キシレンホルムアルデヒド樹脂変性アミノ基含有エポキシ樹脂が、エポキシ樹脂(A)、キシレンホルムアルデヒド樹脂(B)、アミノ基含有化合物(C)、及びポリオール化合物(D)の合計固形分重量を基準にして、エポキシ樹脂(A)を50~85重量%、液状キシレンホルムアルデヒド樹脂(B)を5~45重量%、アミノ基含有化合物(C)を5~25重量%、及びポリオール化合物(D)を1~20重量%の割合で反応させてなるものである請求項13~18のいずれかに記載のカチオン性塗料組成物。

【請求項20】 ポリイソシアネート化合物をブロック 剤によりブロックしてなるブロックポリイソシアネート 架橋剤をさらに含有する請求項1~19のいずれかに記 載のカチオン性塗料組成物。

【請求項21】 ブロックボリイソシアネート架橋剤が、互いに反応性の異なる2個の水酸基を有する分子量76~150のジオール(1)及び分子量106~50

水素含有成分と、ポリイソシアネート化合物とを反応させてなるブロックポリイソシアネート架橋剤である請求 項20に記載のカチオン性塗料組成物。

【請求項22】 防鎖剤としてビスマス化合物をさらに 含有する請求項1~21のいずれかに記載のカチオン性 途料組成物。

【請求項23】 請求項1~22のいずれかに記載のカ チオン性塗料組成物を含んでなるカチオン電着浴。

【請求項24】 請求項1~23のいずれかに記載のカチオン性塗料組成物を用いることを特徴とするカチオン 10 電着塗装方法。

【請求項25】 請求項1~24のいずれかに記載のカチオン性塗料組成物を用いて塗装された物品。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明はカチオン性塗料組成物に関し、さらに詳しくは、防食性、防錆鋼板に対する電着塗装適性に優れた硬化塗膜を形成し得るカチオン性電着塗料組成物に関する。

## [0002]

【従来の技術及びその課題】カチオン性塗料組成物は、主に電着塗料として自動車下塗り用を始め幅広い用途に使用されており、従来から種々の特性を有するものが開発されている。例えば、カチオン性電着塗料組成物としては、基体樹脂の可溶化基としてアミノ基及び/または第4級アンモニウム塩基を含有するエボキシ樹脂をボリアミド、ポリエステル、ポリエーテルなどの可塑剤で内部可塑化してなる変性エボキシ樹脂をビヒクル成分として使用し、さらに、防錆顔料、例えば、クロム酸鉛、塩基性ケイ酸鉛、クロム酸ストロンチウムなどの鉛化合物やクロム化合物を配合してなる、防食性に優れかつ防錆用鋼板に対する電着塗装適性や密着性が改良された塗料組成物が提案されている。

【0003】しかし近年、公害問題の点から、鉛化合物やクロム化合物のような有害性のある化合物の使用は制限されており、そのような有害性化合物を配合しなくても塗膜の防食性を向上させることのできる技術の開発が望まれている。

【0004】他方、可塑剤で内部可塑化されたエポキシ 樹脂は、塗膜の防食性を低下させる傾向があるため、基 40 体樹脂として可塑変性剤を含有しないエポキシ樹脂を使 用することにより防食性を向上させることが考えられる が、その場合、防錆用鋼板に対する電着塗装適性が低下 するという問題がある。

【0005】このような問題を解決するため、エポキシ ホン(ビスフ 樹脂の可塑剤として、例えば、ボリエステルポリオー レゾールノホリオール、ボリエーテルポリオール、ポリウレタンポリオー 【0011】 トドリンとの ジエン、ボリエチレン等のポリオレフィン等の重合体を は、中でも、添加するなどの方法が提案されているが、これらの材料 50 【0012】

はエポキシ樹脂との相溶性が十分でなく、防錆鋼板に対する電着塗装適性などの向上にはあまり効果がないばかりか、多量に添加すると塗膜の防食性が低下するなどの問題がある。

【0006】本発明の目的は、鉛化合物やクロム化合物のような有害な化合物を用いることなく、防食性及び防 錯鋼板に対する電着塗装適性の両者が共に優れた塗膜を 形成し得る、エボキシ樹脂をベースとするカチオン性塗 料組成物を提供することである。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、鋭意研究を重ねた結果、今回、カチオン性塗料組成物におけるビヒクル成分として、エポキシ樹脂に、キシレンホルムアルデヒド樹脂及びアミノ基含有化合物を反応させてなるキシレンホルムアルデヒド樹脂変性アミノ基含有エポキシ樹脂を使用することにより、上記の目的を達成することができることを見出し本発明を完成するに至った。【0008】かくして、本発明は、エポキシ当量が180~2500のエポキシ樹脂(A)に、キシレンホルムアルデヒド樹脂(B)及びアミノ基含有化合物(C)を反応させてなるキシレンホルムアルデヒド樹脂変性アミノ基含有エポキシ樹脂をビヒクル成分として含有することを特徴とするカチオン性塗料組成物を提供するものである。以下、本発明のカチオン性塗料組成物についてさらに詳細に説明する。

#### [0009]

## 【発明の実施の形態】エポキシ樹脂(A)

本発明の塗料組成物においてビヒクル成分として使用される変性エポキシ樹脂の製造において出発材料として用30 いられるエポキシ樹脂としては、塗膜の防食性等の観点から、特に、ポリフェノール化合物とエピハロヒドリン、例えば、エピクロルヒドリンとの反応により得られるエポキシ樹脂が好適である。

【0010】該エポキシ樹脂の形成のために用い得るポリフェノール化合物としては、例えば、ビス(4ーヒドロキシフェニル)-2,2ープロパン(ビスフェノールA)、4,4ージヒドロキシベンゾフェノン、ビス(4ーヒドロキシフェニル)メタン(ビスフェノールF)、ビス(4ーヒドロキシフェニル)-1,1ーエタン、ビス(4ーヒドロキシフェニル)-1,1ーイソブタン、ビス(4ーヒドロキシーセertーブチルーフェニル)-2,2ープロパン、ビス(2ーヒドロキシナフチル)メタン、テトラ(4ーヒドロキシフェニル)-1,1,2,2ーエタン、4,4ージヒドロキシジフェニルスルホン(ビスフェノールS)、フェノールノボラック、クレゾールノボラック等を挙げることができる。

【0011】また、ボリフェノール化合物とエピクロル ヒドリンとの反応によって得られるエポキシ樹脂として は、中でも、ビスフェノールAから誘導される下記式

【0013】で示されるものが好適である。

【0014】エボキシ樹脂(A)は、一般に180~2,500、好ましくは200~2,000、さらに好ましくは400~1,500の範囲内のエボキシ当量を有することができ、また、一般に少なくとも200、特10に400~4,000、さらに特に800~2,500の範囲内の数平均分子量を有するものが適している。

【0015】かかるエポキシ樹脂の市販品としては、例 えば、ジャパンエポキシレジン (株) からエピコート8 28EL、同左1002、同左1004、同左1007 なる商品名で販売されているものが挙げられる。

## キシレンホルムアルデヒド樹脂(B)

本発明において、キシレンホルムアルデヒド樹脂(B)は、好ましくはエボキシ基と反応することが可能なフェノール性水酸基を有し、上記エボキシ樹脂(A)の可塑 20化(変性)に役立つものであり、例えば、キシレン、ホルムアルデヒド、及び場合によりフェノール類を酸性触媒の存在下に縮合反応させることにより製造することができる。

【0016】上記のホルムアルデヒドとしては、工業的に入手容易なホルマリン、パラホルムアルデヒド、トリオキサン等のホルムアルデヒドを発生する化合物などを例示することができる。なお、本明細書において、パラホルムアルデヒド、トリオキサン等の重合体を用いる場合、その配合量の規定は、ホルムアルデヒド1分子を基30準に規定するものとする。

【0017】さらに、上記のフェノール類には2個又は3個の反応サイトを持つ1価もしくは2価のフェノール性化合物が包含され、具体的には、例えばフェノール、クレゾール類(o-クレゾール、m-クレゾール、p-クレゾール)、パラーオクチルフェノール、ノニルフェノール、ビスフェノールプロパン、ビスフェノールメタン、レゾルシン、ピロカテコール、ハイドロキノン、パラーtert-ブチルフェノール、ビスフェノールスルホン、ビスフェノールエーテル、パラーフェニルフェノ 40ール等が挙げられ、これらはそれぞれ単独で又は2種以上の組合わせて用いることができる。この中で特に、フェノール、クレゾール類が好適である。

【0018】以上に述べたキシレン、ホルムアルデヒド、及び場合によりフェノール類の縮合反応に使用されというでは、例えば、硫酸、塩酸、パラトルエンスルホン酸、シュウ酸等が挙げられるが、一般的には、特に硫酸が好適である。その使用量は、通常、ホルムアルデヒド水溶液中の水により希釈されるので、水溶を中の濃度として10~50重量%の範囲内とすること\*50とかりでは、プロピレンイミン、プロピレンイミン、プロピレンイミン、プロピレンイミン、プロピレンイミン、プロピレンイミン、プロピレンイミン

\*ができる。

【0019】 縮合反応は、例えば、反応系に存在するキシレン、フェノール類、水、ホルマリン等が還流する温度、通常、約80~約100℃の温度に加熱することにより行うことができ、通常、2~6時間程度で終了させることができる。

【0020】上記の条件下に、キシレンとホルムアルデヒド、及び場合により且つ好ましくはさらにフェノール類を酸性触媒の存在下で加熱反応させることによって、キシレンホルムアルデヒド樹脂を得ることができる。また、キシレンホルムアルデヒド樹脂をフェノール類と酸性触媒の存在下で反応させることによっても得ることができる。

② 【0021】かくして得られるキシレンホルムアルデヒド樹脂は、フェノール性水酸基を有していることが好ましく、一般に、20~50,000センチポイズ(25℃)、好ましくは30~15,000センチポイズ(25℃)の範囲内の粘度を有することができ、そして一般に100~50,000、特に200~10,000の範囲内のフェノール性水酸基当量を有していることが好ましい。

# アミノ基含有化合物(C)

本発明において、前記エポキシ樹脂(A)に反応せしめられるアミノ基含有化合物(C)は、エポキシ樹脂基体にアミノ基を導入して、該エポキシ樹脂をカチオン化するためのカチオン性付与成分であり、エポキシ基と反応する活性水素を少なくとも1個含有するものが用いられる

【0022】そのような目的で使用されるアミノ基含有化合物としては、例えば、モノメチルアミン、ジメチルアミン、モノイソアロピルアミン、ジイソプロピルアミン、モノブチルアミン、ジブチルアミンなどのモノー、もしくはジーアルキルアミン;モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、モノ(2ーヒドロキシプロピル)アミン、ジ(2ーヒドロキシプロピル)アミン、モノメチルアミノエタノール、モノエチルアミノエタノールなどのアルカノールアミン;エチレンジアミン、プロピレンジアミン、ブチレンジアミン、ペンタエチレンへキサミン、ジエチルアミノアロピルアミン、ジエチレンボリアミン及びこれらのボリアミンのケチミンが増いてエチレングラン、プロピレンボリアミン及びこれらのボリアミンのケチミンが増いてエチレングラン、プロピレングラン

などのアルキレンイミン: ピペラジン、モルホリン、ピ ラジンなどの環状アミンなどが挙げられる。

キシレンホルムアルデヒド樹脂変性アミノ基含有エポキ シ樹脂 : 本発明の塗料組成物においてビヒクルとして使 用されるキシレンホルムアルデヒド樹脂変性アミノ基含 有エポキシ樹脂は、前記のエポキシ樹脂(A)に、キシ レンホルムアルデヒド樹脂(B)及びアミノ基含有化合 物(C)をそれ自体既知の方法で反応させることにより 製造することができる。エポキシ樹脂 (A) に対するキ シレンホルムアルデヒド樹脂(B)及びアミノ基含有化 10 合物(C)の反応は任意の順序で行うことができるが、 一般には、エポキシ樹脂(A)に対して、キシレンホル ムアルデヒド樹脂(B)及びアミノ基含有化合物(C) を同時に反応させるのが好適である。

【0023】上記の付加反応は、通常、適当な溶媒中 で、約80~約170℃、好ましくは約90~約150 ℃の温度で1~6時間程度、好ましくは1~5時間程度 行うことができる。上記の溶媒としては、例えば、トル エン、キシレン、シクロヘキサン、nーヘキサンなどの 炭化水素系;酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチルなど 20 のエステル系; アセトン、メチルエチルケトン、メチル イソブチルケトン、メチルアミルケトンなどのケトン 系;ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドなど のアミド系:メタノール、エタノール、n-プロパノー ル、iso-プロパノールなどのアルコール系;あるい はこれらの混合物などが挙げられる。

【0024】上記の付加反応における各反応成分の使用 割合は、厳密に制限されるものではなく、塗料組成物の 用途等に応じて適宜変えることができるが、エボキシ樹 脂(A)、キシレンホルムアルデヒド樹脂(B)及びア 30 などのジオール類 ; グリセリン、トリメチロールエタ ミノ基含有化合物(C)の3成分の合計固形分重量を基 準にして以下の範囲内が適当である。

【0025】 エポキシ樹脂(A):一般に50~90重 量%、好ましくは50~85重量%、さらに好ましくは 53~83重量%、

キシレンホルムアルデヒド樹脂(B): 一般に5~45 重量%、好ましくは6~43重量%、さらに好ましくは 6~40重量%、

アミノ基含有化合物(C):一般に5~25重量%、好 ましくは6~20重量%、さらに好ましくは6~18重 40 量%。

【0026】本発明によれば、また、エポキシ樹脂 (A)、キシレンホルムアルデヒド樹脂 (B) 及びアミ ノ基含有化合物(C)に加えてさらに、複数の活性水素 基を含有する化合物にカプロラクトンを付加して得られ るポリオール化合物(D)を反応させてなるキシレンホ ルムアルデヒド樹脂変性アミノ基含有エポキシ樹脂をビ ヒクル成分として使用することもできる。

【0027】 ポリオール化合物 (D)

キシ樹脂(A)の可塑化(変性)のために使用されるも のであり、複数の活性水素基を含有する化合物(a)に カプロラクトン(b)を付加することにより製造され る。

8

【0028】活性水素基は少なくとも1個の活性水素を 含有する原子団を意味し、例えば、アルコール性水酸 基、第1級アミノ基、第2級アミノ基などが包含され る。しかして、かかる活性水素基を1分子中に複数個含 有する化合物(a)としては、例えば、(i)低分子量 ポリオール、(ii)線状又は分枝状のポリエーテルポ リオール、(iii)線状又は分枝状のポリエステルポ リオール、(i v)第1級アミノ基及び/又は第2級ア ミノ基を含有するアミノ化合物、或いは第1級アミノ基 及び/又は第2級アミノ基と水酸基とを併有するヒドロ キシアミン化合物などが挙げられる。これらの活性水素 基含有化合物 (a) は、一般に62~5,000、好ま しくは $62\sim4$ , 000、さらに好ましくは $62\sim1$ , 500の範囲内の数平均分子量を有することができる。 また、活性水素基含有化合物(a)は、1分子あたり、 平均して、少なくとも2個かつ30個未満、特に2~1 0個の活性水素基を含有するものが好適である。 【0029】上記の低分子量ポリオール(i)は、1分

子中に少なくとも2個のアルコール性水酸基を含有する 化合物であり、具体的には、例えば、エチレングリコー ル、プロピレングリコール、1,3-ブチレングリコー ル、1,4-ブタンジオール、1,6-ヘキサンジオール、ジ エチレングリコール、ジプロピレングリコール、シクロ ヘキサン-1,4-ジメチロール、ネオペンチルグリコー ル、トリエチレングリコール、水素化ビスフェノールA ン、トリメチロールプロパンなどのトリオール類;ペン タエリスリトール、α-メチルグルコキシドなどのテト ロール類 ; ソルビトール、ジペンタエリスリトールなど のヘキソール類;シュークロースなどのオクトール類等 が挙げられる。

【0030】上記の線状又は分枝状のポリエーテルポリ オール(ii)は、通常62~10,000、好ましく は62~2,000の範囲内の数平均分子量を有するこ とができ、具体的には、例えば、アルキレンオキサイド (例えば、エチレンオキサイド、プロピレンオキサイ ド、ブチレンオキサイド、テトラヒドロフランなど)の 開環付加反応によって製造される、ポリエチレングルコ ール、ポリプロピレングリコール、ポリテトラメチレン グリコール、ポリ (エチレン・プロピレン) グリコー ル、ビスフェノールAエチレングリコールエーテル、ビ スフェノールAポリプロピレングリコールエーテルなど が挙げられる。

【0031】上記の線状または分岐状のポリエステルポ リオール(i i i)は、通常200~10,000、好 本発明において、ポリオール化合物(D)は、上記エポ 50 ましくは200~3,000の範囲内の数平均分子量を

有することができ、具体的には、例えば、有機ジカルボ ン酸又はその無水物と有機ジオールとの、有機ジオール 過剰の条件下での重縮合反応によって得られるものが挙 げられる。ここで使用される有機ジカルボン酸として は、炭素数2~44、特に4~36の脂肪酸系、脂環式 又は芳香族系ジカルボン酸、例えば、コハク酸、アジピ ン酸、アゼライン酸、セバシン酸、マレイン酸、フマル 酸、グルタル酸、ヘキサクロロヘプタンジカルボン酸、 シクロヘキサンジカルボン酸、o-フタル酸、イソフタ ル酸、テレフタル酸、テトラヒドロフタル酸、テトラク 10 ロロフタル酸などが挙げられる。また、これらジカルボ ン酸に加えて、3個以上のカルボキシル基を有するポリ カルボン酸の無水物や不飽和脂肪酸の付加物などを少量 併用することができる。

【0032】また、有機ジオール成分としては、例え ば、エチレングリコール、プロピレングリコール、ブチ レングリコール、1,4-ブタンジオール、1,6-ヘキサン ジオール、ネオペンチルグリコールなどのアルキレング リコールや、ジメチロールシクロヘキサンなどが挙げら れ、これらは場合により、トリメチロールプロパン、グ 20 リセリン、ペンタエリスリトールなどのポリオールの少 量と併有してもよい。

【0033】上記の1級アミノ基及び/又は2級アミノ 基を含有するアミン化合物、或いは第1級アミノ基及び /又は第2級アミノ基と水酸基を併有するアミン化合物 (iv)としては、例えば、ブチレンジアミン、ヘキサ メチレンジアミン、テトラエチレンペンタミン、ペンタ エチレンヘキサミンなどのアルキルアミン類;モノエタ ノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールア ミン、モノ(2-ヒドロキシプロピル)アミン、ジ(2 30 ーヒドロキシプロピル) アミンなどのアルカノールアミ ン類;1,3-ピスアミノメチルシクロヘキサノン、イ ソホロンジアミンなどの脂環族ポリアミン類 ; キシリレ ンジアミン、メタキシレンジアミン、ジアミノジフェニ ルメタン、フェニレンジアミンなどの芳香族ポリアミン 類;エチレンジアミン、プロピレンジアミン、ジエチレ ントリアミン、トリエチレンテトラミンなどのアルキレ ンポリアミン類; さらに、ピペラジンやこれらのポリア ミン類から誘導される、ポリアミド、ポリアミドアミ ン、エポキシ化合物とのアミンアダクト、ケチミン、ア 40 ルジミンなどのその他のアミン化合物を挙げることがで

【0034】以上に述べた複数の活性水素基を含有する 化合物(a)のうち、上記(i)、(ii)及び(i v)の化合物、特に、エチレングリコール、プロピレン グリコール、1,4ーブタンジオール、1,6ーヘキサンジオ ール、ジエチレンゴリコール、水素化ビスフェノール A、グリセリン、トリメチロールエタン、トリメチロー ルプロパン、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリ コール、ポリテトラメチレングリコール、ポリ (エチレ ン・プロピレン) グリコール、ビスフェノールAエチレ ングリコールエーテル、ビスフェノールAポリプロピレ ングリコールエーテル、ブチレンジアミン、ヘキサメチ レンジアミン、モノエタノールアミン、ジエタノールア ミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、イ ソホロンジアミン、エチレンジアミン、プロピレンジア ミン、ジエチレントリアミン及びトリエチレンテトラミ ンよりなる群から選ばれるものが好適である。

【0035】他方、複数の活性水素基を含有する化合物 (a) に付加しうるカプロラクトン(b) としては、ア -カプロラクトン、ε-カプロラクトン、δ-カプロラクトンなどが挙げられ、特にεーカプロラクトンが好適 である。

【0036】上記の複数の活性水素基を含有する化合物 (a)とカプロラクトン(b)の付加反応はそれ自体既 知の方法で行うことができる。具体的には、例えば、テ トラブトキシチタン、テトラプロポキシチタン等のチタ ン化合物:オクチル酸錫、ジブチル錫オキシド、ジブチ ル錫ラウレート等の有機錫化合物;塩化第1錫などの金 属化合物のような触媒の存在下に、複数の活性水素基を 含有する化合物(a)とカプロラクトン(b)とを約1 00~約250℃の温度で約1~約15時間加熱するこ とにより行うことができる。

【0037】上記触媒は、一般に、複数の活性水素基を 含有する化合物(a)とカプロラクトン(b)との合計 量に基づいて0.5~1,000ppmの量で使用する ことができる。また、カプロラクトン(b)は、複数の 活性水素基を含有する化合物(a)の活性水素基1当量 あたり(すなわち、活性水素1個あたり)、一般に1~ 30モル、好ましくは1~20モル、さらに好ましくは 1~15モルの範囲内で使用することができる。

【0038】かくして得られるポリオール化合物 (D) は、複数の活性水素基を有する化合物(a)に基づく高 い可塑化性能と、(ポリ)カプロラクトンに基づくエポ キシ樹脂に対する高い相溶性と、末端水素基による高い 反応性とを兼備しており、塗料用のエボキシ樹脂の可塑 化剤として極めて有用である。

【0039】ポリオール化合物(D)は、一般に、カプ ロラクトン(b)に由来する単位を合計で20~95重 量%、好ましくは25~90重量%の範囲内で含有する ことができ、また、一般に300~10,000、好ま しくは400~5,000の範囲内の数平均分子量を有 することができる。

【0040】上記のポリオール化合物(D)を追加の反 応成分として用いるキシレンホルムアルデヒド樹脂変性 アミノ基含有エポキシ樹脂の製造は、前記の場合と同様 にして行うことができ、一般には、エポキシ樹脂(A) に、キシレンホルムアルデヒド樹脂(B)、アミノ基含 トール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリ 50 有化合物 ( C ) 及びポリオール化合物 ( D ) を同時に反

応させるのが好適である。

【0041】上記の反応における各反応成分の使用割合 は、厳密に制限されるものではなく、塗料組成物の用途 等に応じて適宜変えることができるが、エポキシ樹脂 (A)、キシレンホルムアルデヒド樹脂(B)、アミノ · 基含有化合物 (C) 及びポリオール化合物 (D) の4成 分の合計固形分重量を基準にして以下の範囲内が適当で

【0042】エポキシ樹脂(A):一般に50~85重 量%、好ましくは50~80重量%、さらに好ましくは 10 55~75重量%、

キシレンホルムアルデヒド樹脂(B):一般に5~45 重量%、好ましくは6~40重量%、さらに好ましくは 7~35重量%、

アミノ基含有化合物(C):一般に5~25重量%、好 ましくは6~20重量%、さらに好ましくは7~20重 量%、

ポリオール化合物(D):一般に1~20重量%、好ま しくは2~15重量%、さらに好ましくは2~13重量 %.

<u>カチオン性塗料組成物:</u>本発明により提供されるカチオ ン性塗料組成物は、上記の如くして製造されるキシレン ホルムアルデヒド樹脂変性アミノ基含有エポキシ樹脂を ビヒクルとして含有するものであり、水性塗料、特に電 着塗料において好適に使用される。

【0043】本発明に従うキシレンホルムアルデヒド樹 脂変性アミノ基含有エポキシ樹脂は、例えば、ブロック ポリイソシアネート、メラミン樹脂などの架橋剤、特に ブロックポリイソシアネート架橋剤と組合わせて使用す することができる。

【0044】上記のブロックポリイソシアネート架橋剤 は、ポリイソシアネート化合物とイソシアネートブロッ ク剤とのほぼ化学理論量での付加反応生成物である。こ こで使用されるポリイソシアネート化合物としては、例 えば、トリレンジイソシアネート、キシリレンジイソシ アネート、フェニレンジイソシアネート、ジフェニルメ タン-2, 4'-ジイソシアネート、ジフェニルメタン -4, 4'-ジイソシアネート (通常「MDI」と呼ば れる)、クルードMDI、ビス(イソシアネートメチ ル) シクロヘキサン、テトラメチレンジイソシアネー ト、ヘキサメチレンジイソシアネート、メチレンジイソ シアネート、イソホロンジイソシアネートなどの芳香 族、脂肪族又は脂環族のポリイソシアネート化合物;こ れらのポリイシアネート化合物の環化重合体、イソシア ネートビゥレット体;これらのイソシアネート化合物の 過剰量にエチレングリコール、プロピレングリコール、 トリメチロールプロパン、ヘキサントリオール、ヒマシ 油などの低分子活性水素含有化合物を反応させて得られ

きる。 これらはそれぞれ単独で又は2種以上組合わせて 使用することができる。

【0045】一方、前記イソシアネートブロック剤は、 ポリイソシアネート化合物のイソシアネート基に付加し てブロックするものであり、そして付加によって生成す るブロックポリイソシアネート化合物は常温において安 定であるが、途膜の焼付け温度(通常約100~約20 0℃) に加熱した際、ブロック剤が解離して遊離のイソ シアネート基を再生しうるものであることが望ましい。 【0046】このような要件を満たすブロック剤として は、例えば、εーカプロラクタム、γーブチロラクタム などのラクタム系化合物;メチルエチルケトオキシム、 シクロヘキサノンオキシムなどのオキシム系化合物;フ ェノール、パラーセーブチルフェノール、クレゾールな どのフェノール系化合物; n-ブタノール、2-エチル ヘキサノールなどの脂肪族アルコール類;フェニルカル ビノール、メチルフェニルカルビノールなどの芳香族ア ルキルアルコール類 ; エチレングリコールモノブチルエ ーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテルなど 20 のエーテルアルコール系化合物等を挙げることができ る。これらのブロック剤はそれぞれ単独で又は2種以上 組み合わせて使用することができる。

【0047】これらのブロック剤の他に、互いに反応性 の異なる2個の水酸基を有する分子量76~150のジ オール(1)及び分子量106~500のカルボキシル 基含有ジオール(2)をブロック剤として用いることも できる。 上記のジオール ( 1 ) は、 反応性の異なる 2個 の水酸基、例えば、1級水酸基と2級水酸基、1級水酸 基と3級水酸基、2級水酸基と3級水酸基との組み合わ ることにより、熱硬化性のカチオン性塗料組成物を調製 30 せの2個の水酸基を有し且つ76~150の分子量を有 するものであり、例えば、プロピレングリコール、ジプ ロピレングリコール、1,3-ブタンジオール、1,2 ープタンジオール、3-メチルー1,2-ブタンジオー ル、1,2-ペンタンジオール、1,4-ペンタンジオ ール、3-メチルー4、3-ペンタンジオール、3-メ チルー4,5-ペンタンジオール、2,2,4ートリメ チルー1, 3ーペンタンジオール、1, 5ーヘキサンジ オール、1,4-ヘキサンジオールなどの反応性の異な る2個の水酸基を有するジオール類等を挙げることがで 40 きる。なかでもプロピレングリコールがブロック化ポリ イシアネートの反応性、加熱減量の低減、塗料の貯蔵安 定性などの観点から好適である。これらのジオール (1)は、通常、反応性の高いほうの水酸基からイソシ アネート基と反応しイソシアネート基をブロック化す

【0048】上記のカルボキシル基含有ジオール(2) には、分子量106~500のカルボキシル基含有ジオ ールが包含され、分子中にカルボキシル基を有すること によって、低温解離性が向上し低温での硬化性を向上さ る末端イソシアネート含有化合物などを挙げることがで 50 せることができ、特に、硬化触媒として有機錫化合物を

使用した場合に、低温での硬化性を大きく向上させるこ とができる。カルボキシル基含有ジオール(2)として は、例えば、2,2-ジメチロールプロピオン酸、2, 2-ジメチロールブタン酸、ジメチロール吉草酸、グリ セリン酸等を挙げることができる。

【0049】本発明のカチオン性塗料組成物におけるキ シレンホルムアルデヒド樹脂変性アミノ基含有エポキシ 樹脂とブロックポリイソシアネート架橋剤との配合割合 は、これら両成分の合計固形分重量を基準にして、キシ 脂は一般に50~85重量%、好ましくは55~80重 量%、さらに好ましくは55~78重量%、そしてプロ ックポリイソシアネート架橋剤は一般に15~55重量 %、好ましくは20~45重量%、さらに好ましくは2 2~45重量%の範囲内とすることができる。

【0050】上記のキシレンホルムアルデヒド樹脂変性 アミノ基含有エポキシ樹脂及びブロックポリイソシアネ ート架橋剤を含有する本発明のカチオン性塗料組成物 は、例えば、キシレンホルムアルデヒド樹脂変性アミノ 基含有エポキシ樹脂及びブロックポリイソシアネート架 20 **橋剤を十分に混合した後、通常水性媒体中において、水** 溶性有機カルボン酸で中和して該エポキシ樹脂を水溶化 ないし水分散化することにより調製することができる。 中和のための有機カルボン酸としては、特に、酢酸、ギ 酸又はこれらの混合物が好適であり、これらの酸の使用 により、形成される塗料組成物の仕上がり性、つきまわ り性、低温硬化性、塗料の安定性が向上する。

【0051】本発明の塗料組成物には、防錆剤としてビ スマス化合物を含有せしめることができる。配合しうる 化ビスマス、水酸化ビスマス、塩基性炭酸ビスマス、硝 酸ビスマス、ケイ酸ビスマスなどの無機ビスマス化合物 が挙げられる。特に、これらの中でも水酸化ビスマスが 好ましい。

【0052】また、ビスマス化合物として、2種以上の 有機酸と上記の如きビスマス化合物とを反応させること によって製造され且つ該有機酸の少なくとも1種が脂肪 族ヒドロキシカルボン酸である有機酸ビスマス塩を使用 することもできる。

【0053】該有機酸ビスマス塩の製造に用いうる有機 40 酸としては、例えば、グリコール酸、グリセリン酸、乳 酸、ジメチロールプロピオン酸、ジメチロール酪酸、ジ メチロール吉草酸、酒石酸、リンゴ酸、ヒドロキシマロ ン酸、ジヒドロキシコハク酸、トリヒドロキシコハク 酸、メチルマロン酸、安息香酸、クエン酸などが挙げら ns.

【0054】上記の無機ビスマス化合物及び有機酸ビス マス塩はそれぞれ単独で使用することができ又は2種以 上併用してもよい。

マス化合物の含有量は厳密に規定されるものではなく、 塗料に要求される性能等に応じて広範囲にわたって変え ることができるが、通常、塗料中の樹脂固形分100重 最部あたりのピスマス含有量が0~10重量%、好まし くは0.05~5重量%の範囲内となるようにするのが 適当である.

14

【0056】本発明のカチオン性塗料組成物は、さら に、場合により、硬化触媒として錫化合物を含有するこ とができる。該錫化合物としては、例えば、ジブチル錫 レンホルムアルデヒド樹脂変性アミノ基含有エポキシ樹 10 オキサイド、ジオクチル錫オキサイドなどの有機錫化合 物;ジブチル錫ジラウレート、ジオクチル錫ジラウレー ト、ジブチル錫ジアセテート、ジオクチル錫ジベンゾエ ート、ジブチル錫ジベンゾエートなどのジアルキル錫の 脂肪族または芳香族カルボン酸塩等を挙げることがで き、このうち低温硬化性の点からジアルキル錫芳香族カ ルボン酸塩などが好適である。

> 【0057】本発明の塗料組成物におけるこれらの錫化 合物の含有量は、厳密に規定されるものではなく、塗料 に要求される性能等に応じて広範囲にわたって変えるこ とができるが、通常、塗料中の樹脂固形分100重量部 あたりの錫含有量が0.01~8.0重量部、好ましく は0.05~5.0重量部の範囲内になるようにするの が好適である。

> 【0058】本発明のカチオン性塗料組成物には、さら に必要に応じて、キシレン樹脂、アクリル樹脂などの改 質用樹脂;着色顔料、体質顔料、防錆顔料、有機溶剤、 顔料分散剤、表面調整剤などの塗料添加物を配合するこ とができる。

【0059】本発明のカチオン性塗料組成物は、カチオ ビスマス化合物の種類には特に制限はなく、例えば、酸 30 ン電着塗装によって所望の基材表面に塗装することがで きる。電着塗装は、一般には、固形分濃度が約5~40 重量%、好ましくは15~25重量%となるように脱イ オン水などで希釈し、さらにpHを5.5~9.0の範 囲内に調整した本発明の電着塗料組成物からなる電着浴 を、通常、浴温15~35℃に調整し、負荷電圧100 ~4000の条件で行うことができる。

> 【0060】本発明の塗料組成物を用いて形成される電 着塗膜の膜厚は、特に制限されるものではないが、一般 的には、硬化塗膜に基づいて10~40µm、特に15 ~35µmの範囲内が好ましい。また、塗膜の焼き付け 温度は、被塗物表面で一般に約120~約200℃、好 ましくは約140~約180℃の範囲内の温度が適して おり、焼き付け時間は5~60分程度、好ましくは10 ~30分程度とすることができる。

【0061】本発明のカチオン性塗料組成物は、カチオ ン電着塗料として好適に使用されるが、それに限られ ず、溶剤型塗料として静電塗装、ロール塗装等の方法で 塗装するための防食用プライマーとして使用することも できる。また、本発明の塗料組成物は、架橋剤としてボ 【0055】本発明の塗料組成物におけるこれらのビス 50 リイソシアネート化合物やメラミン樹脂を使用する2液 型常乾塗料や接着剤として使用することもできる。

[0062]

【発明の効果】本発明によれば、カチオン性塗料組成物 中に、エポキシ樹脂 (A)、キシレンホルムアルデヒド 樹脂(B)及びアミノ基含有化合物(C)を反応させて なるキシレンホルムアルデヒド樹脂変性アミノ基含有エ ポキシ樹脂をビヒクル成分として含有せしめることによ り、防食性、付着性、防錆鋼板の電着塗装適性及び塗料 安定性に優れたカチオン性塗料組成物を得ることができ

【0063】以下、実施例により本発明をさらに具体的 に説明する。しかし、本発明は何ら実施例のみに限定さ れるものではない。なお、「部」及び「%」はそれぞれ 「重量部」及び「重量%」である。

[0064]

【実施例】製造例1 キシレンホルムアルデヒド樹脂1 の製造

温度計、還流冷却器及び撹拌機を備えた内容積 2 リット ルのセパラブルフラスコに50%ホルマリン240g、 フェノール55g、98%工業用硫酸101g及びメタ キシレン212gを仕込み、84~88℃で4時間反応 させる。反応終了後、静置して樹脂相と硫酸水相とを分 離した後、樹脂相を3回水洗し、20~30mmHg/ 120~130℃の条件で20分間未反応メタキシレン をストリッピングして、粘度1050センチポイズ(2 5℃) のフェノール変性されたキシレンホルムアルデヒ ド樹脂240gを得た。

製造例2 キシレンホルムアルデヒド樹脂2の製造 製造例1において、フェノール55gの代わりにo-ク レゾール 55gを用いる以外、製造例1と同様にし て、o-クレゾール変性されたキシレンホルムアルデヒ ド樹脂を得た。

製造例3 キシレンホルムアルデヒド樹脂3の製造 製造例1において、フェノール 55gの代りにノニル フェノール 55gを用いる以外、製造例1と同様にし て、ノニルフェノール変性されたキシレンホルムアルデ ヒド樹脂を得た。

製造例4 キシレンホルムアルデヒド樹脂変性アミノ基 含有エポキシ樹脂No. 1の製造

フラスコに、エピコート828EL (ジャパンエポキシ レジン(株)製、商品名、エポキシ樹脂、エポキシ当量 190、分子量350) 1000g、ピスフェノールA 400g及びジメチルベンジルアミン0.2gを加 え、130℃でエポキシ当量750になるまで反応させ

【0065】次に、製造例1で得たキシレンホルムアル デヒド樹脂1を300g、ジエタノールアミンを140 g及びジエチレントリアミンのケチミン化物を65g加 え120℃で4時間反応させた後、ブチルセロソルブを 420g加え、アミン価52、樹脂固形分80%の樹脂 50 コスモネートM-200(三井化学株式会社製、商品

No. 1を得た。

製造例5 キシレンホルムアルデヒド樹脂変性アミノ基 含有エポキシ樹脂No. 2の製造

16

製造例4において、キシレンホルムアルデヒド樹脂1の 300gの代わりに、製造例2で得たキシレンホルムア ルデヒド樹脂2を300g使用する以外は製造例1と同 様の操作を行い、アミン価 52、樹脂固形分80%の 樹脂No. 2を得た。

製造例6 キシレンホルムアルデヒド樹脂変性アミノ基 10 含有エポキシ樹脂No. 3の製造

製造例4において、キシレンホルムアルデヒド樹脂1の 300gの代わりに、製造例3で得たキシレンホルム アルデヒド樹脂3を300g使用する以外は製造例1と 同様の操作を行い、アミン価 52、樹脂固形分80% の樹脂No.3を得た。

製造例7 キシレンホルムアルデヒド樹脂変性アミノ基 含有エボキシ樹脂No. 4の製造

PP-400 (三洋化成社製、商品名、ポリプロピレン グリコール、分子量400)400gに $\epsilon$ -カプロラク トン300gを加えて、130℃まで昇温した。その 後、テトラブトキシチタン 0.01gを加え、170 ℃に昇温した。この温度を保ちながら経時でサンプリン グし、赤外吸収スペクトル測定にて未反応のε-カプロ ラクトン量を追跡し、反応率が98%以上になった時点 で冷却し、ポリオール化合物を得た。

【0066】次に、別のフラスコにエピコート828E L (ジャパンエポキシレジン (株) 製、商品名、エポキ シ樹脂、エポキシ当量190、分子量350)1000 g、ビスフェノールA 400g及びジメチルベンジル 30 アミン0.2gを加え、130℃でエポキシ当量750 になるまで反応させた。次に、製造例1のキシレンホル ムアルデヒド樹脂1を200g、ポリオール化合物を1 00g、ジエタノールアミンを140g及びジエチレン トリアミンのケチミン化物を65g加え、120℃で4 時間反応させた後、ブチルセロソルブを420g加え、 アミン価52、樹脂固形分80%の樹脂No. 4を得 た。

製造例8 アミノ基含有エポキシ樹脂NO. 5の製造 エピコート828EL(ジャパンエポキシレジン(株) 製、商品名、エポキシ樹脂) 1010gに、 ビスフェノ ールA 390g及びジメチルベンジルアミン0.2g を加え、130℃でエポキシ当量800になるまで反応 させた。次に、ジエタノールアミン160g及びジエチ レントリアミンのケチミン化物65gを加え、120℃ で4時間反応させた後、ブチルセロソルブ355gを加 え、アミン価67、固形分80%の樹脂No.5を得

製造例9 ブロックポリイソシアネート硬化剤No. 1 の製造

名、クルードMDI)270gにメチルイソブチルケト ン46gを加え70℃に昇温した。 ジエチレングリコー ルモノエチルエーテル281gをゆっくり加えた後、9 ○℃に昇温した。この温度を保ちながら、経時でサンプ リングし、赤外吸収スペクトル測定にて未反応のイソシ アネートの吸収がなくなったことを確認することによ り、溶剤量を調整し、固形分90%のブロックポリイソ シアネート硬化剤No. 1を得た。

製造例10 ブロックポリイソシアネート硬化剤No. 2の製造

反応容器中にコスモネートM-200 270部及びメ チルイソブチルケトン25部を加え70℃に昇温した。 その中に2,2-ジメチロールブタン酸15部を徐々に 添加し、ついでエチレングリコールモノブチルエーテル 118部を滴下して加え、70℃で1時間反応させた 後、60℃に冷却し、プロピレングリコール152部を 添加した。この温度を保ちながら、経時でサンプリング し、赤外線吸収スペクトル測定にて未反応のイソシアナ ト基の吸収がなくなったことを確認し、固形分80%の 硬化剤No. 2溶液を得た。

製造例11 ブロックポリイソシアネート硬化剤No. 3の製造

反応容器中にコスモネートM-200(商品名、三井化 学社製、クルードMDI)270部及びメチルイソブチ ルケトン4gを加え70℃に昇温した。その中に2,2 -ジメチロールブタン酸15部を徐々に添加し70℃で 1時間反応させた後、60℃に冷却し、プロピレングリ コール270部を添加し、この温度を保ちながら、経時 でサンプリングし、赤外線吸収スペクトル測定にて未反 応のイソシアナト基の吸収がなくなったことを確認し、 30 【表1】

固形分75%の硬化剤No.3溶液を得た。

\*製造例12 カチオン電着用クリアーエマルション (a)の製造

上記製造例4で得られた樹脂No.1を87.5g(樹 脂固形分で70g)、製造例9で得られたブロックボリ イソシアネート硬化剤No. 1 を33.3g (樹脂固 形分で30g)、ジブチル錫ジベンゾエート(固形分4 0%)を2.5g及び10%酢酸を15g配合し、均一 に攪拌した後、脱イオン水158.7gを強く攪拌しな がら約15分かけて滴下し、固形分34%のカチオン電 10 着用クリアーエマルション(a)を得た。

製造例13~18 カチオン電着用クリアーエマルショ ン(b)~(g)の製造表1に示す成分の組み合わせを 用い、製造例12と同様にしてエマルション(b)、 (c)、(d)、(e)、(f)及び(g)を得た。 製造例19 カチオン電着用クリアーエマルション (h)の製造

製造例8で得られた樹脂No. 5 を73. 8g (樹脂 固形分で59g)、製造例9で得られたブロックポリイ ソシアネート硬化剤No. 1を 33.3g (樹脂固形 20 分で30g)、製造例1で得られたフェノール変性され たキシレンホルムアルデヒド樹脂を11g、ジブチル錫 ジベンゾエート (固形分40%)を2.5g、及び10 %酢酸を15g配合し、均一に撹拌した後、脱イオン水 161. 4gを強く攪拌しながら約15分かけて滴下 し、固形分34%のカチオン電着用クリアーエマルショ ン(h)を得た。

【0067】表1に、カチオン電着用クリアーエマルシ ョン (a) ~ (h) の配合内容を示す。

[0068]

	製造例12	製造例13	製造例14	製造例15	製造例18	製造例17	製造例18	製造例19
エマルノシンろ	(a)	(b)	(a)	(d)	(0)	(f)	(g)	(b)
樹鹽No. 1	87.6				87.5	87.5		
	(70)				(70)	(10)		
<b>樹脂No. 2</b>		87.5						ł
	l	(70)						
初期No. 3			87.5		1	ļ		[
	ł		(70)				L	
樹原No. 4			1	87.5	l			
				(70)				
Milino. 5			J	•		ļ	87.5	73.8
	<u> </u>						(70)	(59)
フェノール変性された				l				11.0
キシレンホルムアルデヒド樹脂1								(11)
プロック化ポリイソシアネート	33.3	39.3	33.8	38.3	Ì	1	33.3	33.2
硬化剂 No.1	(30)	(30)	(30)	(30)		<u> </u>	(30)	(30)
ブロック化ポリイソシアネート			ł .		33.3		Į.	ł
硬化剂 No. 2			—		(30)		<b>_</b>	<del></del>
ブロック化ポリイソシアネート	ì	l	1	1	1	83.3	1	ı
硬化剂 No. 3						(30)		
ジブチル信ジベンゾエート	2.5	2.5	2.5	8.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
10%酵酸	15	15	15	15	15	15	15	15
脱イオン水	158.7	158.7	158.7	158.7	158.7	158.7	158.7	161,4
34%エマルション	297	297	297	297	297	297	297	297
2 :	(101)	(101)	(101)	(101)	(101)	(101)	(101)	(101)

## 【0069】顔料分散ペーストの製造

60%の第4級塩化エポキシ樹脂5.83部、チタン白 14.5部、カーボンブラック0.4部、体質顔料 7. 0部及び水酸化ビスマス2. 0部に脱イオン水2. 24部を加え、十分に撹拌して、固形分55%の顔料分 散ペーストを得た。

19

# 実施例及び比較例

#### 実施例1

カチオン電着用クリアーエマルション(a)297部 に、顔料分散ペースト49.8部及び脱イオン水23 5. 7部を加え、固形分20%のカチオン電着塗料を得 た。

実施例2~6及び比較例1~2

実施例1と同様にして、カチオン電着用クリアーエマル\*

\*ション (b) ~ (h) のそれぞれに顔料分散ペースト及 び脱イオン水を、実施例1と同様の配合割合で加え固形 分20%のカチオン電着塗料を得た。

#### 塗装試験

上記実施例及び比較例で得た各カチオン電着塗料中に、 パルボンド#3020(日本パーカライジング社製、商 品名、リン酸亜鉛処理剤)で化成処理した0.8×15 0×70mmの亜鉛メッキ鋼板を浸漬し、これをカソー ドとして電着塗装を行った(防錆鋼板の塗装電圧:27 10 0V)。形成された電着塗膜を、電着熱風乾燥機を用い て焼き付けた。得られた塗装板の性能試験結果を下記表 2に示す。

[0070]

【表2】

				38.1	<u>-</u>					
			実施例1	実施例 2	実施例3	麦施例4	突施例 5	突施例 6	比較倒1	比較例2
グリナーエマルション			(a)	(P)	(c)	(a)	<b>(i)</b>	3	(g)	(h)
防衛用銅板電管論性(注1)		0	0	0	0	0	0	Δ	0	
<b>飲 膜 性 </b>	防衛性(性2)	150°C	0	0	0	0	0	0	×	×
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	170°C	0	<b>©</b>	<b>©</b>	<b>Ø</b>	0	0	0	
	副新黎性(注3)	150°C	40	40	40	40	50<	50<	10	20
		170°C	50<	50<	50<	50<	50<	50<	20	40
	副水2次付着性(结4)	150°C	0	0	0	0	0	0	Δ.	×
	<b></b>	170°C	O	0	0	0	0	0	0	0
	任提耐無曲性(注向)	150°C.	0	0	0	0	0	0	×	×
		170°C	0	0	0	0	0	0	×	×
	硬化性(社后)	150℃	0	0	0	0	Ø	6	Δ	×
		170°C	0	Ö	0	0	<b>Ø</b>	0	0	0

【0071】性能試験は下記の方法に従って実施した。 (注1)防錥用鋼板電着適性: 亜鉛メッキ鋼板を電着浴 のカソードとして浸漬し、電圧270 V、浴温度28℃ 30 にてカチオン電着塗装し170℃で20分間焼付け硬化 を行った後のテストピースについて、10×10cm中 のピンホールの数を数える。○はピンホールの発生な し、△は3~5個発生、×は10個以上発生、を示す。 (注2) 防食性: カチオン電着塗料を施し、150℃で 20分間、170℃で20分間の2水準で焼き付けるこ とにより得られた各電着塗板に、素地に達するように電 着塗膜にナイフでクロスカット傷を入れ、これをJIS Z-2371に準じて840時間耐塩水噴霧試験を行 い、ナイフ傷からの錆、フクレ幅によって以下の基準で 評価した。◎は、錆、フクレの最大幅がカット部より2 mm未満 (片側) でかつ塗面全体にブリスターの発生が ない、Oは、錆、フクレの最大幅がカット部より2mm 以上、3mm未満 (片側) でかつ塗面全体にブリスター の発生がない、△は、錆、フクレの最大幅がカット部よ り3mm以上、4mm未満 (片側) でかつ塗面の一部に ブリスターの発生がみられる、×は、錆、フクレの最大 幅がカット部より4mm以上、及び/又は塗面全体にブ リスターの発生がみられる、ことをそれぞれ示す。

※で20分間、170℃で20分間の2水準で焼き付ける ことにより得られた各試験板を、温度20±1℃、湿度 75±2%の恒温恒湿室に24時間置いたのち、デュポ ン衝撃試験器に規定の大きさの受台と撃心を取り付け、 試験板の塗面を上向きにして、その間に挟み、次に50 Ogの重さのおもり撃心の上に落とし、衝撃による塗膜 のワレ、ハガレがない最大高さ(cm)を測定した。 (注4)耐水2次付着性:亜鉛メッキ鋼板にカチオン電 着塗料を施し、150℃で20分間、170℃で20分 間の2水準で焼き付けることにより得られた試験板を、 さらに、TP-65グレー(関西ペイント社製、商品 名、アミノアルキド系中塗り塗料) 及びネオアミラック 6000 (関西ペイント社製、商品名、アミノアルキド 系上塗り塗料)を順次塗装し、焼き付け硬化させた塗板 を用い、40℃の温水に10日間浸漬した。そののち2 mm角のゴバン目カットを入れセロテープ(登録商標) 剥離試験を行い、塗膜の残存割合(残存個数/100) を評価する。○は、100/100、△は、90~99 /100、×は、89以下/100、をそれぞれ示す。 (注5) 低温耐屈曲性: 150℃で20分間、170℃ で20分間の2水準で焼き付けることにより得られたカ チオン電着塗膜試験板を、温度 マイナス20±1℃、 (注3) 耐衝撃性: カチオン電着塗料を施し、150℃※50 湿度75±2%の恒温、恒湿室に24時間置いたのち、

1~2秒で180℃折り曲げを行う。折り曲げ部分の表 裏両面共に異常のない場合を○とし、少なくともどちら かに一方にワレ、ハガレ等の異常のある場合を×とし た。

21

(注6) <u>硬化性</u>: 150℃で20分間、温度170℃で20分間の2水準で焼き付けることにより得られたカチオン電着塗板の塗面を、アセトンをしみこませた4枚重ねのガーゼで、圧力0.392MPa(約4kgf/c

m²)で約3~約4cmの長さを約20往復こすった時の塗面外観を目視で観察し以下の基準で評価した。 【0072】◎は、30往復にて塗面に傷が認められない、〇は、20往復にて塗面に傷が認められない、Δは、20往復にて塗面に傷が認められるが素地はみえない、×は、20往復にて塗膜が溶解し素地がみえる、ことをそれぞれ示す。

# フロントページの続き

(72)発明者 御堂河内 奨

神奈川県平塚市東八幡4丁目17番1号 関西ペイント 株式会社内

(72)発明者 富永 章

神奈川県平塚市東八幡4丁目17番1号 関 西ペイント 株式会社内 (72)発明者 嶋崎 昭彦

神奈川県平塚市東八幡4丁目17番1号 関西ペイント 株式会社内

(72)発明者 飯島 英基

神奈川県平塚市東八幡4丁目17番1号 関

西ペイント 株式会社内

Fターム(参考) 4J038 DA101 DB001 DB061 DB461